

貼付け装置 卓上型 / 据置型

特 徴

サファイア、SiC、GaN ウェハーなどの薄基板をセラミックやガラスなどの支持基板（貼り付け板）にワックス接着させるための貼り付け装置で、薄基板を支持基板に高精度に貼り付けるため、下記特徴があります。

① 貼り合せ時、真空脱泡することが可能

ワックスに含まれる泡や、反ったウェハーを貼り付けるときに入ってしまう空気など、真空状態で貼り付けるため脱泡させることができます。

② 貼り合せ圧力は上室部の空気圧送によるダイヤフラム方式（エアバック）

空気圧力によって試料を均等に加圧させるため、支持基板にムラなく均一に貼り合わせることが出来ます。

③ 貼り合せ設定はシーケンサーによるプログラムコントロール

試料を貼り合わせる一連の作業をシーケンサーと温度コントローラーにて制御しているので、条件設定すればセミオート化が出来ます。

④ 冷却は間接水冷却にて降温時間をコントロール可能

ワックスの硬化時間（冷却時間）を設定することが出来るので、急速冷却によるワックスの収縮を防ぐことが出来ます。

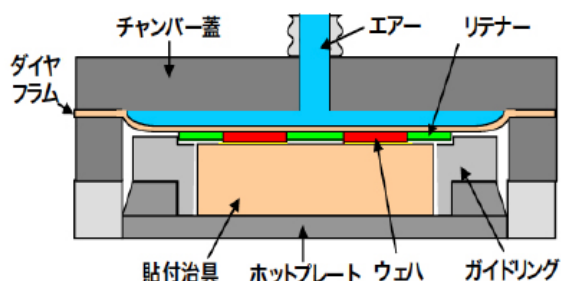


Kemet 250S（卓上型）



Kemet 500 II（据置型）

貼付け機構概略図



※リテナー：ウェハの位置決め治具  
ガイドリング：貼付治具・リテナーの位置決め治具

実 績

仕様\型式	Kemet 250S	Kemet 500 II
対象支持基板径	～Φ 180mm	Φ 400x20mmT
ホットプレート設定温度範囲	常温～ 200℃	常温～ 200℃
加圧範囲	～ 0.3MPa	～ 0.3MPa
加圧時間	1sec ～ 4,000sec	1sec ～ 4,00sec
入力電源	AC200V	AC200V
消費電力	20A	50A
寸法 (mm)	630W x 400D x 520H	680W x 1,000D x 2500H
重量 (kg)	約 100	約 600

※上記は過去に実績のある装置の仕様です。詳細はお問い合わせ下さい。